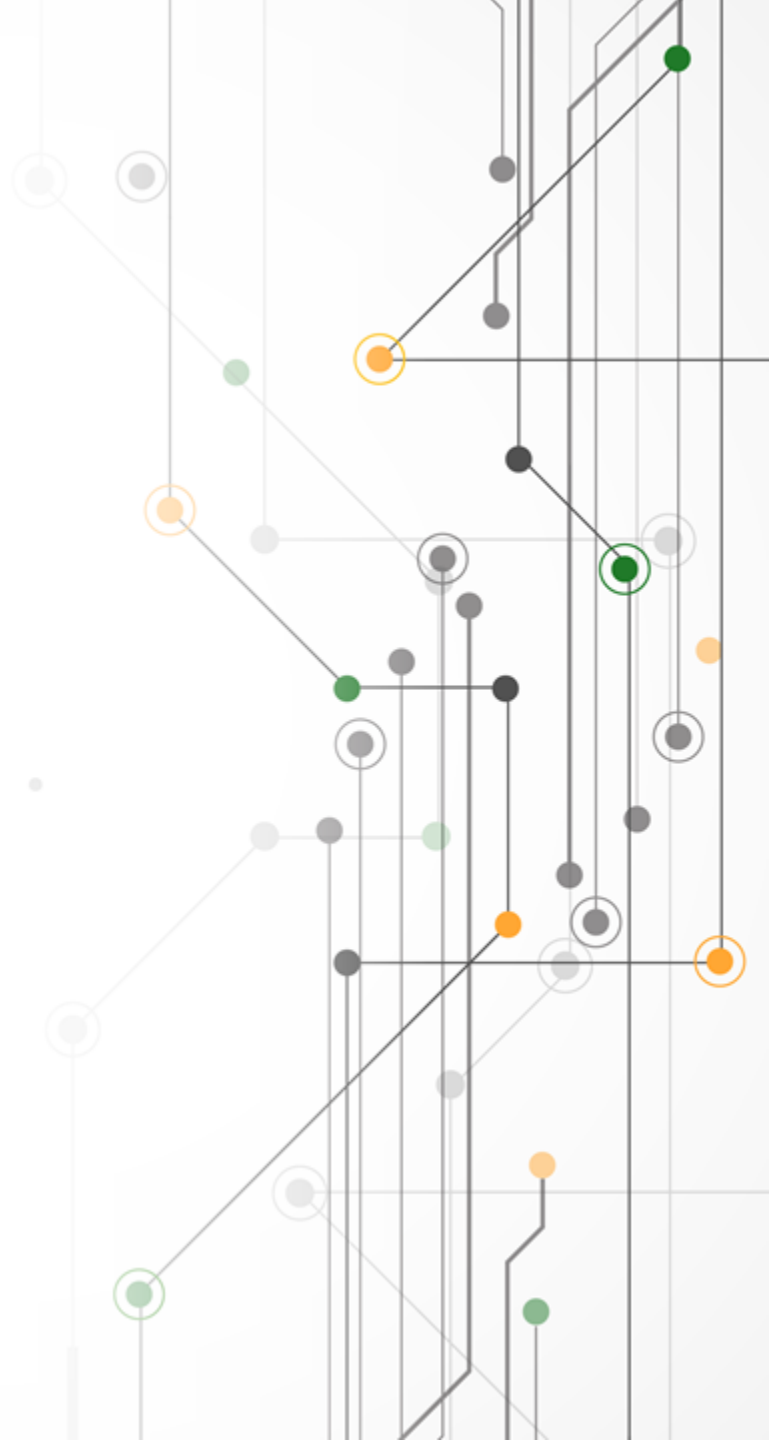


株式会社リョーサン 2021年度第2四半期 決算補足資料

2021年12月3日

株式会社リョーサン



決算概要

経営方針・施策

資料取扱い上のご注意

本資料で述べられている業績計画等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。その要因のうち、主なものは以下のとおりです。

- ・主要市場（日本、アジア等）の経済状況、消費動向及び製品需給の急激な変動
- ・ドル等の対円為替相場の大幅な変動
- ・資本市場における相場の大幅な変動等



連結業績の概要

RYOSAN

- 2021年度上期連結業績は、売上高が前年同期比+27.8%の1,242億円、営業利益は同比+227.2%の40億円と増収増益。

(単位：億円)	2020年度		2021年度		
	上期実績	2021年7月28日付 予想	上期実績	前年同期比	予想比
売上高	971	1,210	1,242	+27.8%	+2.7%
売上総利益	81	110	116	+42.5%	+5.7%
営業利益	12	36	40	+227.2%	+13.8%
(売上高比)	(1.3%)	(3.0%)	(3.3%)	(+2.0pt)	(+0.3pt)
経常利益	16	37	40	+142.3%	+9.7%
(売上高比)	(1.7%)	(3.1%)	(3.3%)	(+1.6pt)	(+0.2pt)
当期純利益	14	27	29	+95.9%	+7.7%
(売上高比)	(1.5%)	(2.2%)	(2.3%)	(+0.8pt)	(+0.1pt)
1株当たり当期純利益(円)	63.39	115.24	124.17	+95.9%	+7.7%
米ドル 期中平均為替レート(円)	106.92	—	109.80	+2.7%	—



RYOSAN

売上高・経常利益の増減要因

2021年度第2四半期

業績結果

- 売上高は自動車向け回復、新規ビジネスも寄与し、前年同期比+271億円の1,242億円。
- 販売管理費増や前年同期営業外為替差益の剥落あったが、売上ボリューム増、産業機器向け等高付加価値製品の販売好調に加え、在庫関連費用減少もあり、経常利益は前年同期比+24億円の40億円。

図1. 売上高 (億円)

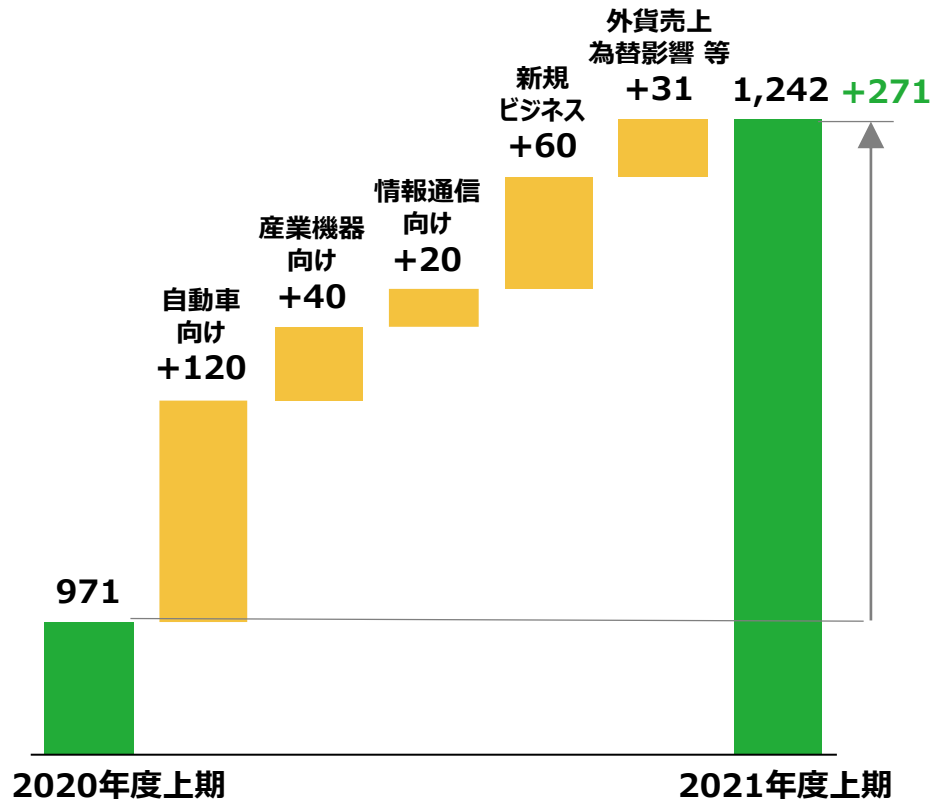
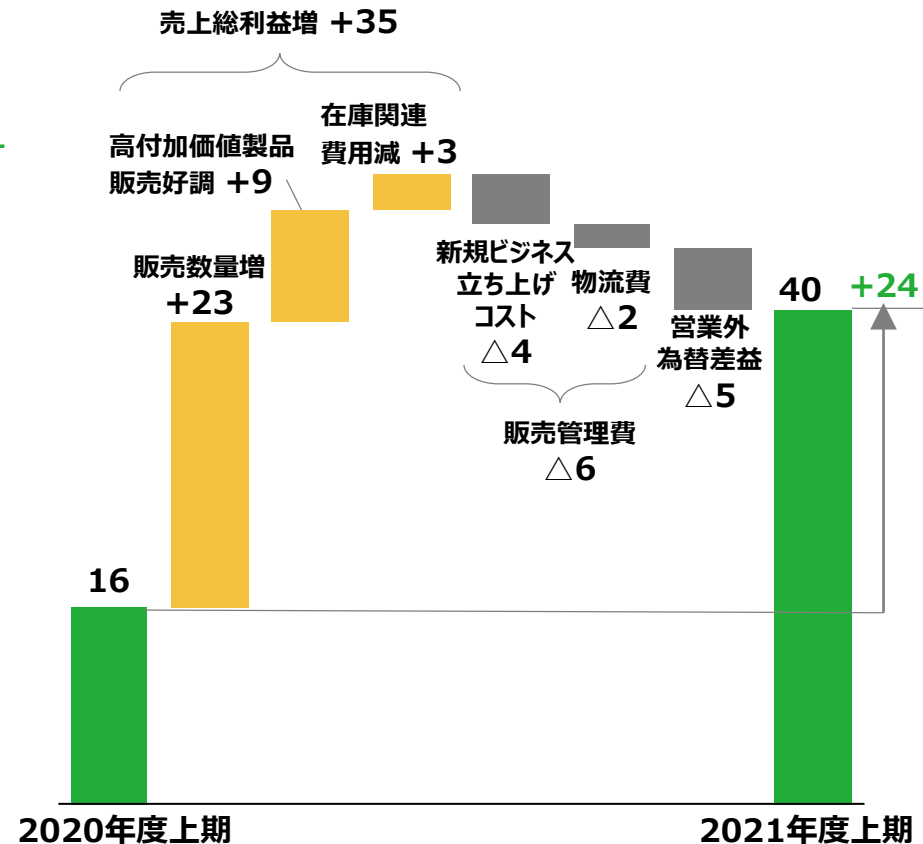


図2. 経常利益 (億円)



事業別業績の概要

RYOSAN

- デバイス事業は、幅広い用途で販売数量が伸長し、売上高は前年同期比+27.5%の1,096億円。営業利益は高付加価値製品販売等も寄与し、同比+172.1%の34.6億円。
- ソリューション事業は、自動車向けを中心に前年同期比で伸長した他、設備機器に係る大型案件もあり、売上高は前年同期比+30.2%の146億円。営業利益は増収に加え、営業費用抑制運用が奏功し、同比+231.3%の6.6億円。

(単位：億円)	2020年度		2021年度	
	上期実績		上期実績	前年同期比
デバイス事業	売上高	859	1,096	+27.5%
	営業利益	12.7	34.6	+172.1%
	(売上高比)	(1.5%)	(3.2%)	(+1.7pt)
ソリューション事業	売上高	112	146	+30.2%
	営業利益	2.0	6.6	+231.3%
	(売上高比)	(1.8%)	(4.5%)	(+2.7pt)
	営業利益調整額	△2.2	△ 0.2	
計	売上高	971	1,242	+27.8%
	営業利益	12.5	40.9	+227.2%
	(売上高比)	(1.3%)	(3.3%)	(+2.0pt)

※. 2021年度からの報告セグメント変更

旧セグメント

半導体事業	メモリ・システムLSI・個別半導体
電子部品事業	表示デバイス・電源・機構部品
電子機器事業	システム機器・設備機器

新セグメント

デバイス事業	半導体（メモリ・システムLSI・個別半導体）、電子部品（表示デバイス・機構部品）
ソリューション事業	システム機器(*1)、ソリューション(*2)

*1. 旧電子機器事業のシステム機器・設備機器、旧電子部品事業の電源を合わせている。

*2. 従来はソリューションに係る収益は各セグメントに含めていた。



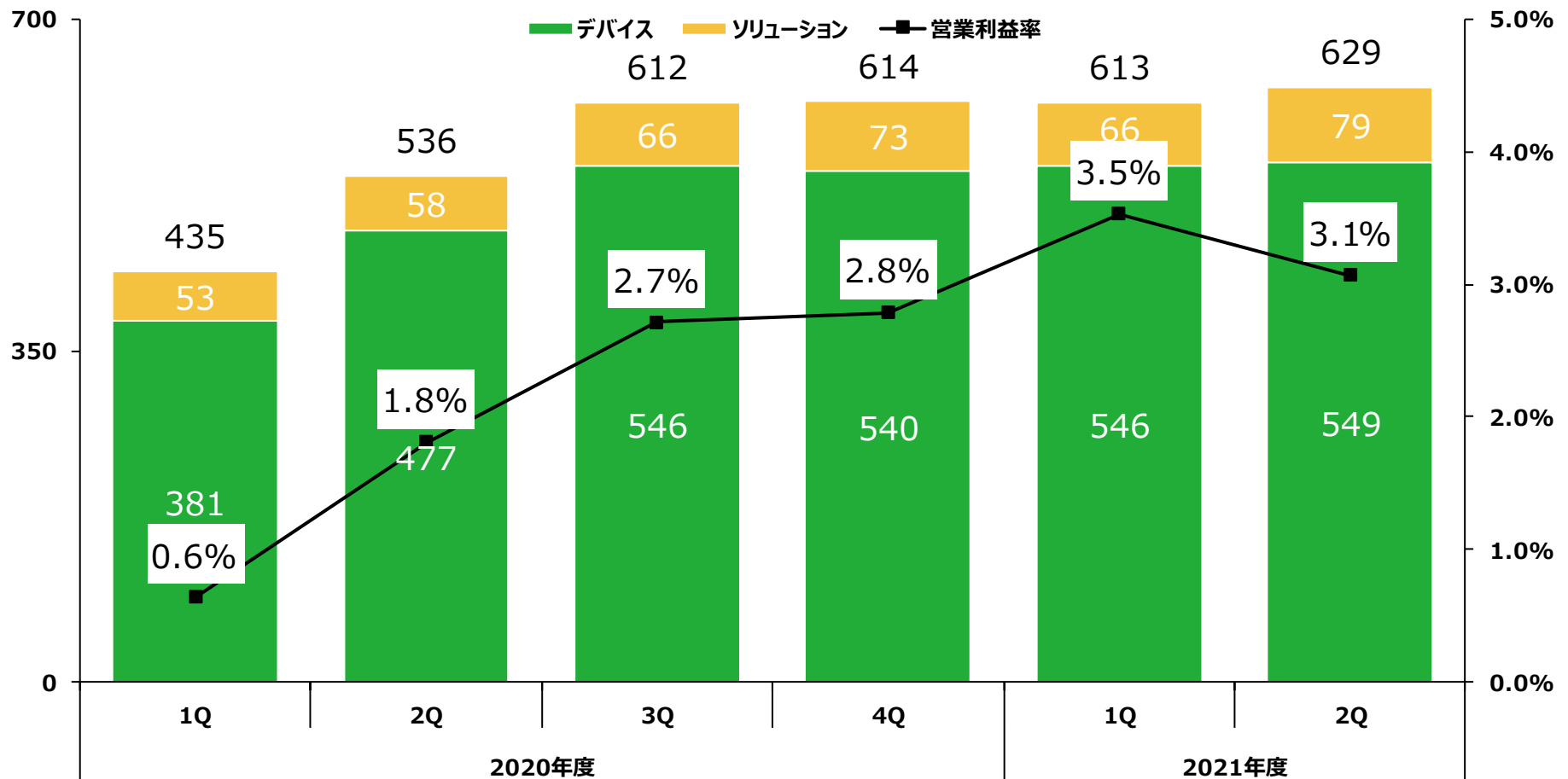
RYOSAN

四半期毎 売上高・営業利益率

2021年度第2四半期
業績結果

- 売上高は2020年度3Q以降は600億円を超える水準で推移。
- 営業利益率は、売上高好調と売上総利益率改善により2021年度1Q以降3%台を堅持。

売上高（単位：億円）

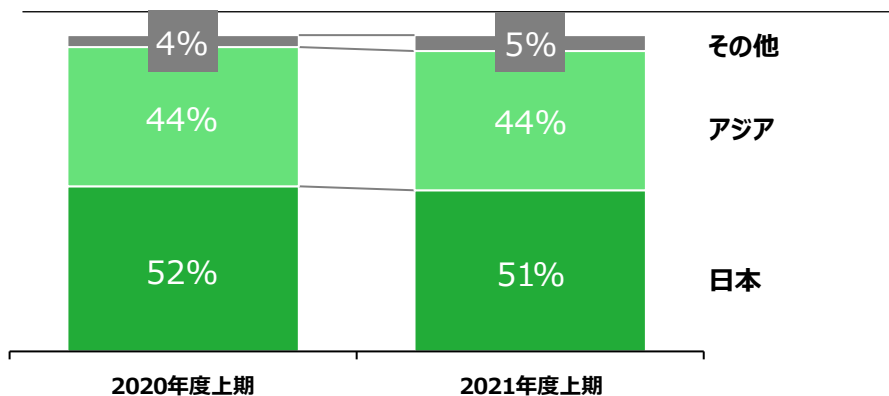


事業セグメントの推移

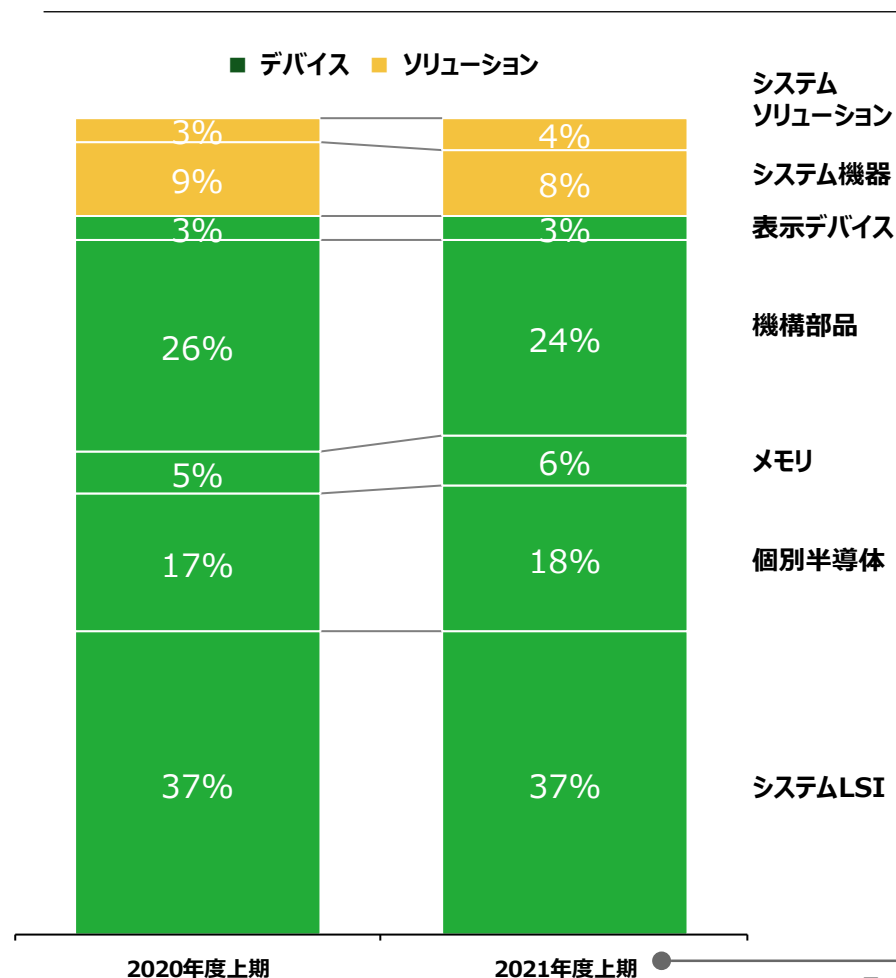
RYOSAN

- 地域別の売上高構成には、大きな変化なし。用途別では、コロナによるマイナス影響から回復した自動車、伸長が続いた産業機器向けの割合が増加。商品別では、巣ごもり需要一巡による消費者向け減速の影響を受けた機構部品の割合が低下。

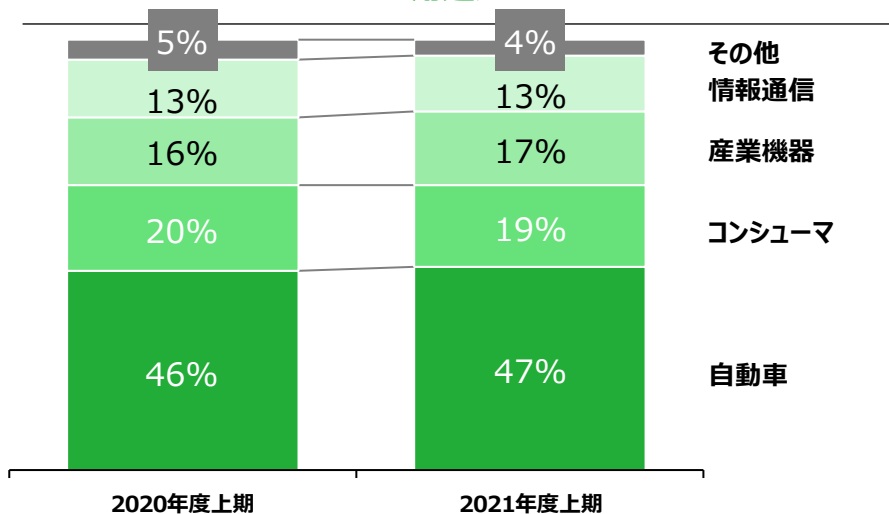
地域別



商品別



用途別





- 2021年9月末の連結貸借対照表は、顧客の生産調整、同BCP在庫対応、サプライヤー製造中止対応等あり、棚卸資産が前期末比+113億円。結果、総資産は前期末比+75億円の1,555億円、営業CFは△51億円。

連結貸借対照表

(単位：億円)	2020年9月末	2021年3月末	2021年9月末	前期末比
総資産	1,378	1,480	1,555	+75
流動資産	1,223	1,324	1,401	+77
受取手形及び売掛金	555	710	713	+3
棚卸資産	406	357	470	+113
固定資産	155	155	153	△2
負債	523	584	647	+63
買掛金	261	329	360	+38
短期借入金	204	185	216	+31
純資産	855	896	907	+11
自己資本比率	62.1%	60.5%	58.3%	△2.2pt

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：億円)	2020年度上期	2020年度下期	2021年度上期	前期比
営業活動によるキャッシュ・フロー	△63	25	△51	△76
投資活動によるキャッシュ・フロー	3	6	△1	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	20	△36	11	+47
現金及び現金同等物の期末残高	205	206	163	△43

連結予想の概要

RYOSAN

- 2021年度通期連結業績は、コロナ影響や半導体不足等により、下期の事業環境が不透明で弱含みであることを勘案し、売上高は通期では前年度比+6.4%の2,340億円と小幅増収の見込み。
- 営業利益は、上期で高付加価値製品販売が一巡した他、物流費高止まりや旅費交通費等の営業費用増加を想定し、通期では前年度比+23.1%の57億円の見込み。

(単位：億円)	2020年度		2021年度予想		
	上期	通期	上期	通期	前年度比
売上高	971	2,198	1,242	2,340	+6.4%
売上総利益	81	190	116	207	+8.8%
営業利益	12	46	40	57	+23.1%
(売上高比)	(1.3%)	(2.1%)	(3.3%)	(2.4%)	(+0.3pt)
経常利益	16	51	40	58	+13.2%
(売上高比)	(1.7%)	(2.3%)	(3.3%)	(2.5%)	(+0.2pt)
当期純利益	14	45	29	42	△8.4%
(売上高比)	(1.5%)	(2.1%)	(2.3%)	(1.8%)	(△0.3pt)
1株当たり当期純利益(円)	63.39	195.78	124.17	195.78	△8.4%
米ドル 期中平均為替レート(円)	106.92	106.06	109.80	108.40	+2.2%

事業別予想の概要

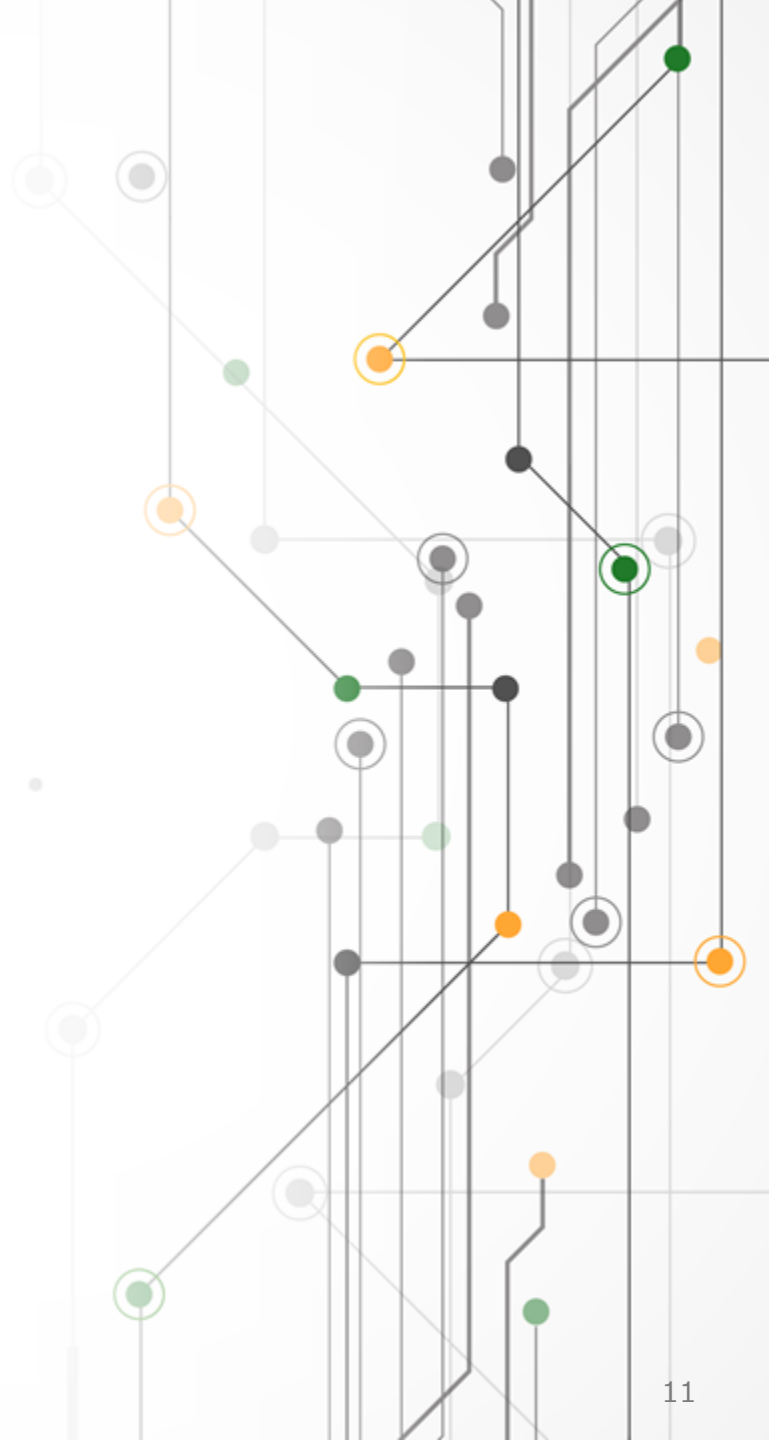
RYOSAN

- デバイス事業の売上高は、下期にかけて自動車生産台数減、巣ごもり需要の反動減の影響を受ける見込みで、通期では前年度比+5.3%の2,050億円の見込み。営業利益は高付加価値製品が販売一巡することから、同比+21.9%の50.0億円の見込み。
- ソリューション事業は、下期に情報通信向け大型案件が立ち上がるものの相対的に利益率が低く、売上高は通期では前年度比+14.8%の290億円、営業利益は同比+45.0%の9.5億円の見込みながら、営業利益率は同比+0.7ptの3.3%に留まる。

(単位：億円)	2020年度		2021年度予想			
	上期	通期	上期	通期	前年度比	
デバイス事業	売上高	859	1,946	1,096	2,050	+5.3%
	営業利益	12.7	41.0	34.6	50.0	+21.9%
	(売上高比)	(0.8%)	(2.1%)	(3.2%)	(2.4%)	(+0.3pt)
ソリューション事業	売上高	112	252	146	290	+14.8%
	営業利益	2.0	6.5	6.6	9.5	+45.0%
	(売上高比)	(1.8%)	(2.6%)	(4.5%)	(3.3%)	(+0.7pt)
	営業利益調整額	△2.2	△1.2	△0.2	△2.5	
計	売上高	971	2,198	1,242	2,340	+6.4%
	営業利益	12.5	46.2	40.9	57.0	+23.1%
	(売上高比)	(1.3%)	(2.1%)	(3.3%)	(2.4%)	(+0.3pt)

決算概要

経営方針・施策



上期の振り返り



RYOSAN

- 2021年度から第11次中期経営計画をスタート。長期ビジョンに沿った6つの施策が骨子。
- 収益改善に向けた「守備」固めモードから事業体質変革に向けた「攻め」のモードにシフト。

長期ビジョン R S イノベーション 2030

成長に向けての3つのイノベーション

ビジネス・
イノベーション

ネットワーク・
イノベーション

チャネル・
イノベーション

実現に向けての事業インフラの整備

業務プロセス

技術力 (ナレッジ)

ガバナンス

人材 (リソース)

財務 (ファイナンス)

2021年5月公表 「第11次中期経営計画」施策の骨子

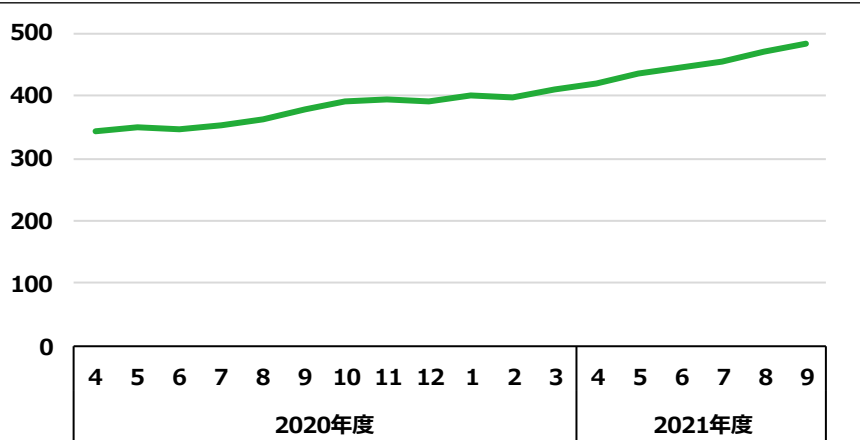
施策	概要
ポートフォリオの 多様化推進	・商権獲得先の深掘りやチャネル改革
中華圏ローカル 事業の深化	・地場出資先との協働
先行投資商材 の刈り取りと 新規投資	・各種先行投資案件の中で本計画期間中に 成立が見込まれる大型案件の刈り取り ・新規商材の発掘・事業立ち上げの推進
業態変革に 向けた投資	・顧客ニーズを起点とする製造事業を含む 新規ビジネス参入等
既存ビジネスの 効率化	・様々なデジタル技術の活用
基盤整備	・経営情報や教育・リスク管理・ガバナンス等の 整備



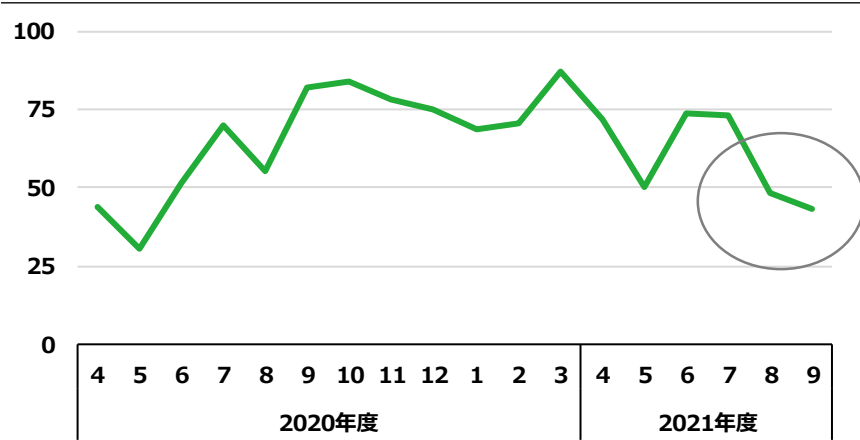
RYOSAN

- 半導体世界売上高は右肩上がりで増加。電子部品グローバル出荷高も高水準を維持。
- 自動車、黒物家電の国内生産は足元前年同月比を割った。

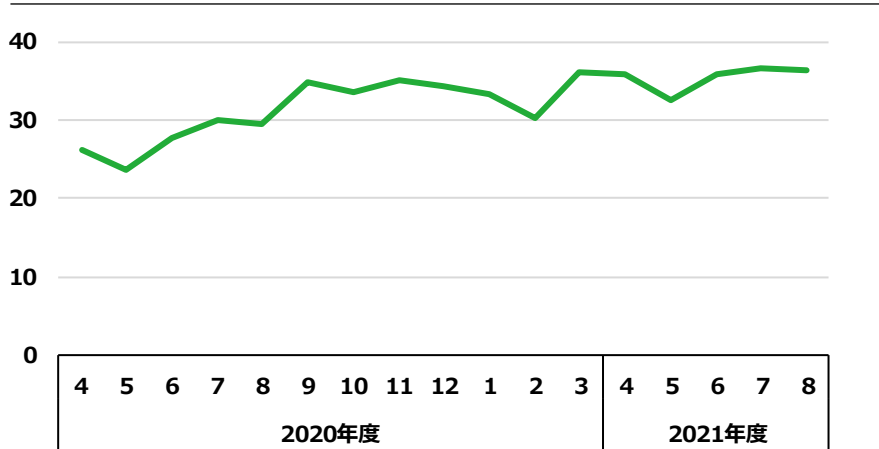
半導体世界売上高（月別 億ドル 出所：WSTS）



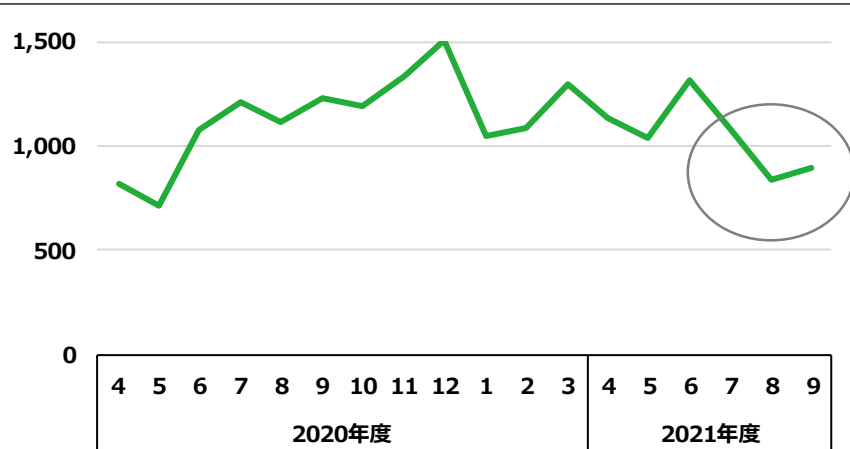
自動車国内生産台数（月別 万台 出所：JAMA）



電子部品グローバル出荷金額（月別 百億円 出所：JEITA）



黒物（映像/音響）国内出荷金額（月別 億円 出所：JEITA）



足元の事業環境

半導体・電子部品の
供給不足状況の継続

コロナによるビジネス活動の
停滞と足元の正常化

サプライヤーの
代理店政策変更

インパクト

- 高水準の受注動向継続
- 需給ギャップ解消による市況反転への備えの必要性
- ダイレクトチャネル活用等DXを活用した業務効率化へのインセンティブ
- 物流等コスト上昇
- ロックダウン等サプライチェーン停滞に伴う棚卸資産増加
- 商権変更による新たなビジネスチャンス
- 決済手法変更対応に向けた追加投資対応

□ : プラス要因
■ : マイナス要因

第11次中期経営計画の進捗状況と下期施策



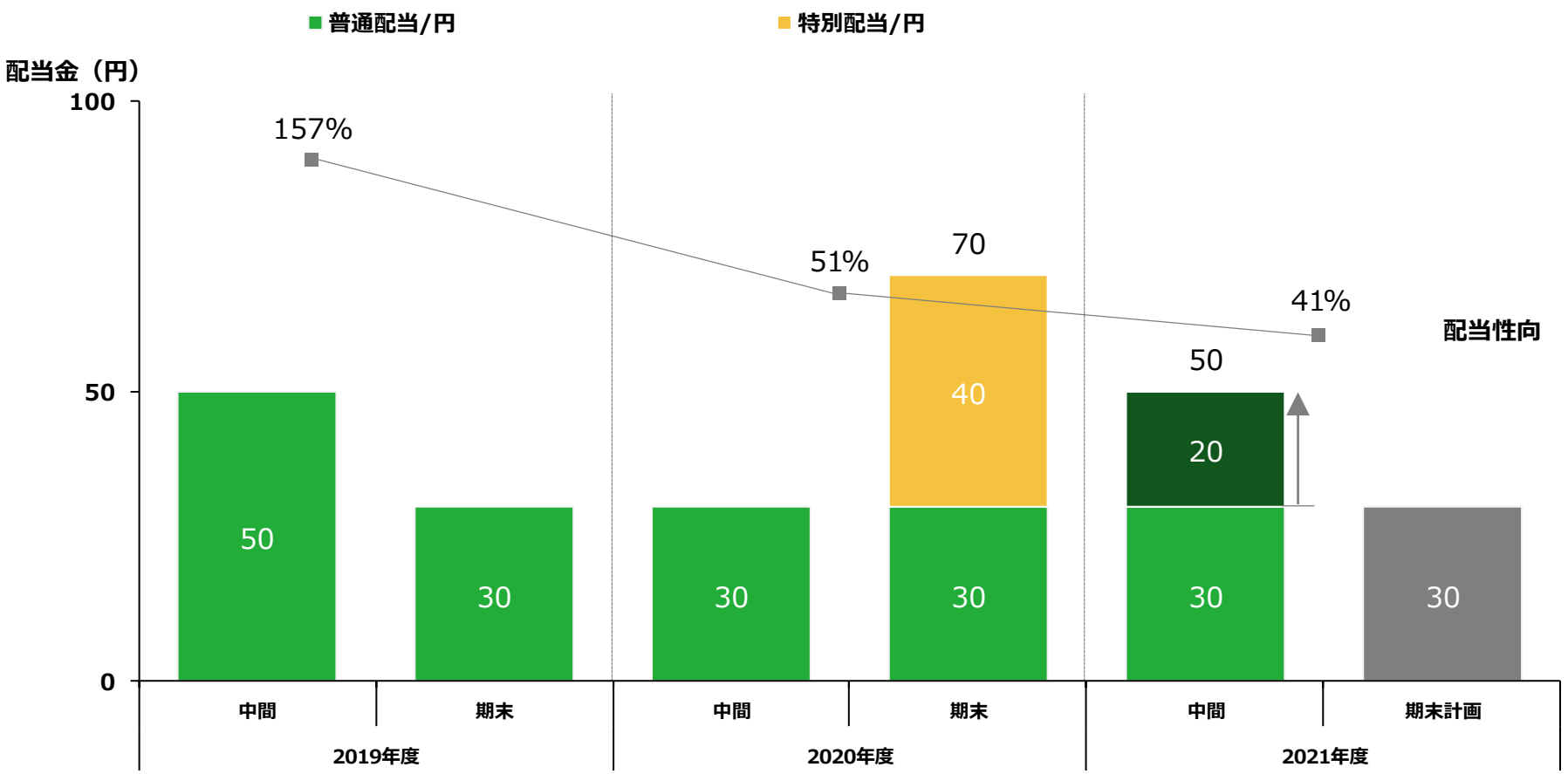
施策	実績	下期施策
ポートフォリオの 多様化推進	<ul style="list-style-type: none"> ・中小企業向け販路開拓に向けたダイレクトチャネルインフラ整備 	<ul style="list-style-type: none"> ・商権移管分のビジネス拡大に向けた投資 ・ダイレクトチャネルインフラ整備継続
中華圏ローカル事業の 深化	<ul style="list-style-type: none"> ・ローカルパートナーとの協働推進 ・中国子会社とのシナジー追及 	<ul style="list-style-type: none"> ・ソリューションビジネスの拡充 ・中国子会社とのシナジー拡大
先行投資商材の 刈り取りと新規投資	<ul style="list-style-type: none"> ・本部体制変更（半導体、電子部品事業本部の一体化） ・商品開拓の専担機能の立ち上げ 	<ul style="list-style-type: none"> ・新規開拓の加速化 ・先行投資案件刈り取り
業態変革への投資	<ul style="list-style-type: none"> ・新事業開発専担機能の強化 	<ul style="list-style-type: none"> ・成長期待分野への拡販 ・顧客ニーズ蓄積活動の高度化
既存ビジネスの 効率化	<ul style="list-style-type: none"> ・社内横断的業務デジタル化推進プロジェクトの立ち上げ 	<ul style="list-style-type: none"> ・システム開発推進
基盤整備	<ul style="list-style-type: none"> ・人事制度の刷新に向けた取り組み ・データ基盤の再構築 	<ul style="list-style-type: none"> ・人事制度リリース ・データ基盤の統合に向けた全体設計、開発

株主還元計画



- 2021年度中間配当金は、2021年度第2四半期業績等を勘案し、直近配当予想の1株当たり30円から20円増配し、50円。

1株当たり配当金



参考) 半導体製品 初期解析受託サービス



RYOSAN

- 当社は半導体専門商社として、半導体のデバイス技術サポートや開発サポート（ソフトウェア・ハードウェアの受託開発）、システムソリューションの構築を行っている。
- デバイス技術サポートの一つとして半導体初期解析受託サービスを展開。半導体不足の今、市場在庫品の真贋判定ニーズに対するソリューションとして引き合い増加中。

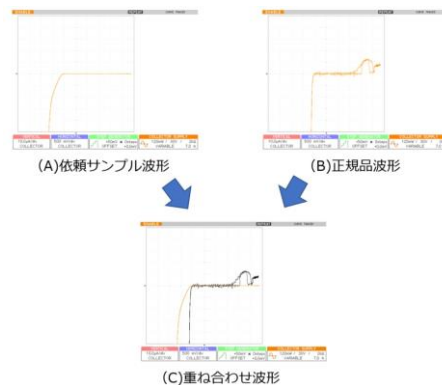
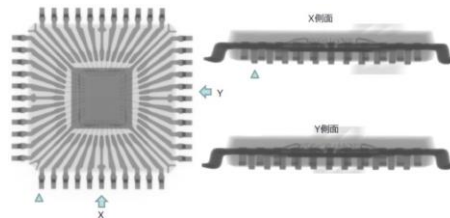
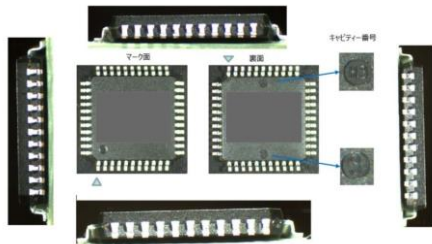
半導体初期解析受託サービス 内容

1. 梱包確認

2. パッケージ外観確認

3. 内部構造確認

4. 電気的特性確認



*. 2021年11月24日 日本経済新聞に本サービスが掲載されました